

证券代码：688726

证券简称：拉普拉斯

拉普拉斯新能源科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☒ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位	东方红资管、富国基金、国寿安保基金、国泰海通证券、华创证券、汇添富基金、交银基金、平安资产、万家基金、兴全基金、中欧基金等
时间	2026 年 7 月 20 日、7 月 21 日
地点	投资者办公室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书 夏荣兵 投资者关系总监 关东奇来
投资者关系活动主要内容介绍	投资者问答： 1、公司光伏设备的下游市场需求和产品布局情况如何？ 答：光伏发电相较于传统能源发电已极具经济性，光伏行业装机需求的长期增长趋势，以及光伏电池片技术的持续迭代都将为设备厂商带来更多的市场机会，尤其是能够带来降本增效的新工艺、新技术的设备需求强烈。目前光伏设备市场需求主要包含具备技术竞争力的先进产能建设需求、存量产线技术升级需求（如 TOPCon 和 XBC 存量产线的进一步技术升级和优化等）、海外市场需求等。 2026 年 6 月 27 日国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布国家标准 GB 47834—2026《晶体硅光伏组件和逆变

	器能效限定值及能效等级》，标准将于 2027 年 1 月 1 日正式实施。根据该国家标准，晶体硅光伏组件能效等级分为 3 级（其中 1 级能效最高），符合 3 级能效等级的 TOPCon、HJT、BC 电池光伏组件的光电转换效率分别不应低于 23.2%、23.2%、23.5%。我们认为，光伏行业发展模式正从“规模扩张”向技术创新驱动的“高质量发展”转型，上述国家标准的实施有利于改善光伏产业的供需结构，加快推动存量产能向先进产能（高功率、高效率产品）的技术升级进程，打开新的设备市场空间。 目前，TOPCon 产能可以通过半片/多分片、边缘钝化、激光 Poly 减薄、栅线优化等技术升级手段实现更高的转换效率和功率；XBC 产能则可以通过硅片优化、满屏组件、栅线优化、减银/去银技术等技术实现进一步降本增效。公司紧跟客户需求，在深入覆盖了 TOPCon、XBC 等技术路线的各类热制程、镀膜及配套自动化设备的基础上，持续开发了半片/多分片、边缘钝化（EPD）、激光 Poly 减薄以及减银/去银相关设备，助力下游客户产能的技术升级和降本增效。 同时，公司持续推动对激光设备、磁控溅射物理气相沉积平台、新一代核心 CVD 工艺设备、钙钛矿核心真空工艺设备、新型金属化设备等领域的前瞻研究和技术探索，持续丰富公司的产品及技术储备，为未来业务拓展奠定坚实基础，构筑关键技术护城河。 2、除光伏设备业务之外，公司布局了哪些新业务领域？ 答：公司立足高效光伏电池核心工艺设备领域优势，向半导体分立器件、集成电路先进封装、科学仪器等创新领域有序延伸，通过底层技术平台复用、产品迭代创新、全球化生态布局与产业数智化升级，致力于成为全球领先的泛半导体高端装备与核心工艺解决方案提供商，持续以技术创新驱动产业高质量发展。
--	--

	在半导体分立器件领域，公司将持续完善氧化、退火、镀膜等一系列半导体分立器件设备的开发与优化，丰富产品类型，提升半导体分立器件领域的竞争力；在半导体集成电路领域，公司积极研发应用于先进封装领域的半导体沉积设备，致力于实现在集成电路领域的突破，强化公司在半导体集成电路领域的技术实力；在科学仪器领域，公司重点推进产品的开发与验证。 3、公司年报中披露了在研项目“半导体沉积设备”，请介绍一下该产品的用途？目前进展如何？ 答：公司在研项目“半导体沉积设备”拟达到目标为开发第一代半导体沉积设备，该项目对应产品为半导体先进封装所需的电化学沉积设备（ECD，即电镀设备），可兼容 8-12 英寸晶圆，支持铜、镍、金、锡银、镍铁等多类金属电镀，可应用于半导体封装的 RDL、微凸块、TSV 等电镀工艺。 2026 年上半年，该项目已完成 α 机验证（公司内部验证原型机），目前已进入 β 机验证阶段（量产验证机，在下游企业现场进行机台验证，尚未取得正式销售订单）。 该项目能否验证成功，以及未来应用和推广情况仍存在一定不确定性，公司将持续完善、丰富技术和产品，为下游客户提供更具行业竞争力的核心工艺解决方案。 4、定增预案相关研发项目的主要投向？ 答：根据公司《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》，募集资金净额将用于光伏及半导体高端装备研发项目、无锡光伏高端装备基地二期建设项目、数字化与智能化升级项目、补充流动资金。 其中，光伏及半导体高端装备研发项目主要拟投入光伏、半导体相关领域。在光伏领域，通过进一步深入研发 TOPCon、
--	---

	XBC、钙钛矿等不同技术路线所需的核心设备，同时加强光伏多设备集群优化、工厂少人化、智能化等方向的研发投入，以持续夯实公司在高效光伏电池核心工艺设备及解决方案领域的领先地位；在半导体领域，通过深化集成电路先进封装设备研发，不断完善产品矩阵布局，提升公司在半导体设备领域的竞争力，进一步完善覆盖光伏与半导体产业的研发体系，拓宽公司的技术护城河并提升业务成长空间。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	不涉及
附件清单(如有)	无

风险提示：以上如涉及对行业预测、公司发展战略和经营计划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。